

**■ディスプレイデバイス（液晶・有機EL他）・タッチセンサー・部材**

**□有機EL、韓国勢巻き返し サムスン・LG、8年ぶりシェア拡大** 2026. 3. 10

AI ロボや自動運転車 用途広げ中国猛追かわす

韓国のパネル大手が有機ELで巻き返しに出る。サムスンディスプレイとLGディスプレイ（LGD）の大手2社のシェアは中国勢の台頭を受け減少が続いたが、2025年は8年ぶりに上昇した。大型テレビ用など高価格品の需要開拓が寄与した。今後はAIでロボットや機械を動かす「フィジカルAI」向けの需要を取り込めるかが焦点おなりそう。



左：サムスンがスペインの見本市「MWC」で披露したロボット。顔部分に円形の有機ELパネルを採用。

右：LGディスプレイが1月に米で開催された「CES」で発表した超大型車載パネル

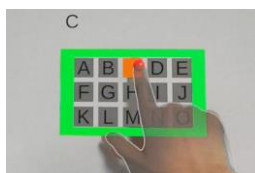
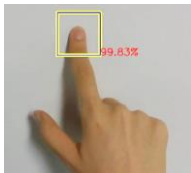
**□JDI、車載パネル事業の分社化を中止 コスト増など影響** 2026. 3. 12

ジャパンディスプレイは12日、予定していた車載パネル事業の分社化を中止すると発表した。JDIは「事業環境や経営状況の変化を踏まえ、事業を一体的に運営する」とした。2025年5月に公表した構造改革の一環だったが、分社化に伴うコスト増などが影響した。

**□杉金光電 偏光板を年産3億m<sup>2</sup>に 大型化なども推進** 2026. 3. 12

中国の杉金光電は偏光板市場でのシェア拡大に向けて、2026年に年産能力3億m<sup>2</sup>の構築を目標としており、25年には100インチ超えの偏光板の安定供給体制を確立した。世界市場シェアは22年に29%に達し世界1位の座を維持している。25年に自主開発したPSA PFASフリー（パーフルオロとポリフルオアールキル基を含まない接着剤）の製品を開発した。

**□東北大、指先の色変化でタッチ検出 インターフェース技術開発** 2026. 3. 26



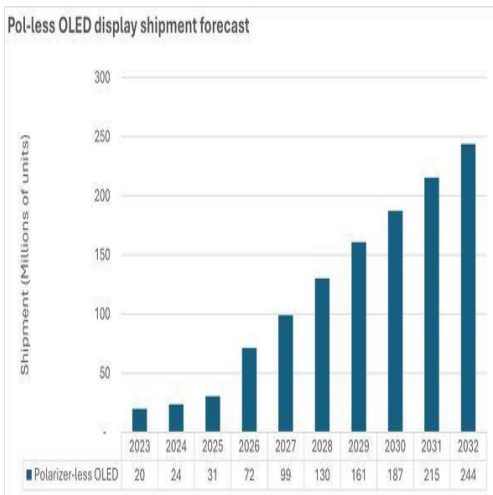
ブランディング現象の検出例

操作インターフェースの利用例

東北大学の趙廣翰特任研究員と北村喜文教授らは、指で壁などを押し指先が白くなる現象を利用してタッチを検出するインターフェース技術を開発した。壁や机、家具などのさまざまなモノを利用できる。拡張現実（AR）や複合現実（MR）デバイスなどの操作に提案していく。堅いモノに指先を押しつけると圧力で血液が一時的に移動し、爪や肌が白く見えるブランディング現象を利用する。ARグラスやヘッド・マウント・ディスプレイ（HMD）のカメラで手を撮影し、画像認識で指先の色変化を判定する。 1

□POL-LESS 構造 OLED、26 年から急成長 Samsung も採用

2026. 3. 12



POL-LESS 構造 OLED 出荷台数予測 出所 : Omdia

市場調査会社の Omdia は、POL-LESS (Polarizer-less) 構造有機 EL (OLED) の出荷台数予測を発表した。それによると、2026 年の出荷台数 7200 万台から年平均成長率 (CAGR) 22.7%で成長し、2032 年には 2 億 4400 万台に達する見込みだという。従来の OLED は円偏光板 (CPL) を用いて各ピクセルからの光を直線的に通過させていたが、この方式では実際の発光と比べ、確保できる輝度が半減するほか、単層フィルム層が比較的厚いことから設計、性能に影響を及ぼしていた。そこで OLED メーカーは近年、偏光板をなくした POL-LESS 構造 OLED の技術開発を行っている。これまではプレミアム製品での採用にとどまっていたが、適用用途も拡大傾向にあり、OLED 市場のイノベーションを加速させているという。例えば OLED 封止層の上にカラーフィルターとブラックマトリックスをパターンニングする「COE (Color Filter-on-Encapsulation)」は、CPL よりも薄く、光の取り出し効率が高い。このことから折り畳み式スマートフォンや、高輝度、長時間駆動が求められるスマホでの採用が拡大しているという。また偏光板を用いない技術として、ディスプレイ表面全体の光透過率を制限することで偏光する「SPL (Simplified Polarizer Layer)」を挙げる。本技術はコントラスト比の低下、視野角の狭まり、屋外での視認性の低下といったデメリットもあるが、従来の偏光板技術よりもコストが低いため、低コスト OLED パネルへの採用技術として有力視されているという。

□JDI、茂原工場売却で半導体の米マイクロンと交渉 「複数候補」の 1 社 2026. 3. 27

ジャパンディスプレイ (JDI) が液晶パネルの主力拠点だった茂原工場の売却で、米メモリー大手のマイクロン・テクノロジーと交渉していることが 26 日わかった。JDI は「複数の事業者と交渉している」としており、マイクロンはそのうちの 1 社となる。成立した場合の売却額は数百億円とみられ、JDI は売却益で経営再建を急ぐ。

## ■半導体

### □キヤノン、国内大手で初 ラピダスに生産委託 2 ナノ半導体、経産省支援 2026. 3. 2

先端半導体の量産を目指すラピダスは、キヤノンから画像処理用の半導体の生産を受託する。国内の大手需要家が顧客候補になるのは初めて。経済産業省が開発費の一部を支援し、ラピダスの課題だった顧客開拓を後押しする。実績を積み上げ、国内企業にラピダスとの連携を促す。両社は回路線幅 2 ナノメートルの画像処理用半導体をラピダスの北海道の工場で作成する。キヤノンは半導体設計最大手の米シノプシスと共同開発し、同社を通じて生産委託する。

### □DRAM急騰、1カ月で2倍 大口価格 AI 需要増え品薄に 2026. 3. 4

半導体メモリーのDRAMの価格が急騰している。1月の大口取引価格は指標となるDDR4型8ギガビット品が1個13.0ドル前後と、2025年11～12月の2倍の高値で決着した。1年前に比べると7.4倍にのぼる。世界大手が人工知能(AI)向けの供給を優先し、PCなどに使う汎用品の生産を絞っているため。調達難は一段と深刻化している。

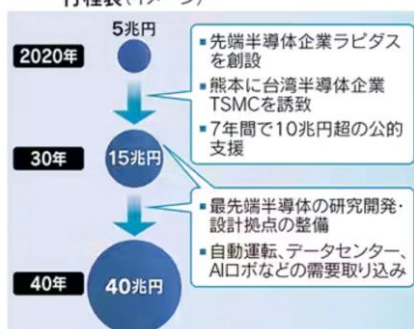
### □AI半導体の次の主戦場は「ガラス基板」——SKC・Absolicsが6000億ウォン投資、Intel・TSMCも参戦 2026. 3. 4

韓国SKCがガラス基板子会社Absolicsに6000億ウォン超を投資する計画を発表。IntelやTSMCも参入し、AI半導体性能を左右する次世代パッケージ競争が本格化している。従来材料が物理的限界に近づくなか、次世代チップパッケージングの中核としてガラス基板が急浮上している。韓国では、Samsung Electro-Mechanicsが世宗にパイロットラインを設置し、2027年以降の量産を目標とする。LG Innotekも亀尾にパイロットラインを構築し、年内試作を開始する予定だ。米国ではIntelが10億ドル超を投資し、2030年までの標準化を目指している。台湾ではTSMCがFOPLP専任R&Dチームを立ち上げ、TGVとガラス基板を統合するロードマップを推進している。中国ではAppleサプライヤーとして知られるLens TechnologyがTGVガラス基板分野への参入を発表している。

### □国産半導体の売上高目標「2040年に40兆円」 政府、最先端研究へ拠点 2026. 3. 8

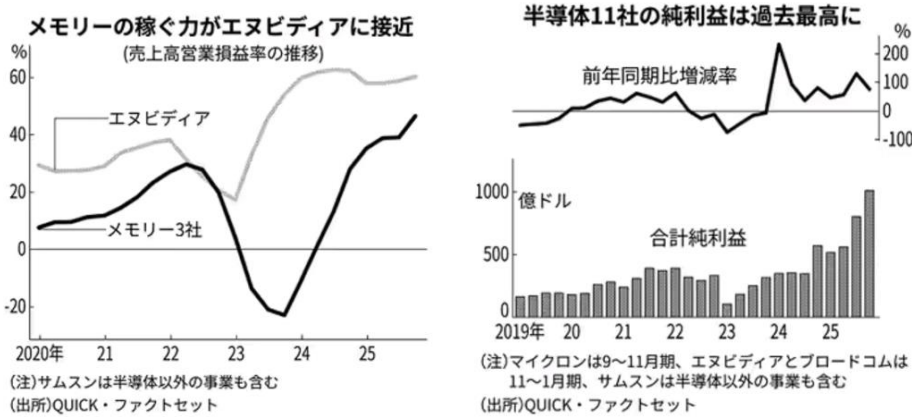
政府は国内で生産される半導体の売上高を2040年に40兆円まで増やす目標を据える方針だ。人工知能(AI)やデータセンターの需要拡大に備え、最先端半導体の研究・開発拠点を整備する。国が方向性を示し、民間企業が投資しやすい環境をつくる。10日にも日本成長戦略会議(議長・高市早苗首相)を開き、官民連携した「危機管理・成長投資」の行程表の素案を示す。半導体の売上高目標も盛り込む。

国産半導体の売上高拡大に向けた行程表(イメージ)



**□世界の半導体企業、最高益 メモリー3社の稼ぐ力がNVIDIAに接近** 2026. 3. 6

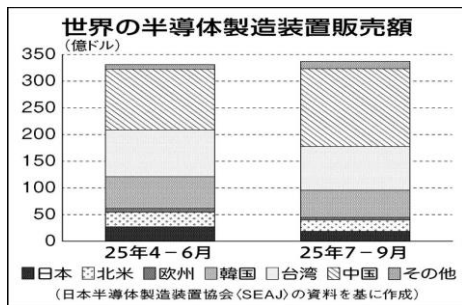
世界の主要半導体 11 社の 2025 年第 4 四半期決算は純利益合計が前年同期比で 8 割増え、四半期として過去最高だった。人工知能 (AI) 向け需要で価格が高騰するメモリーを手がける 3 社合算の売上高営業利益率は 47%と米エヌビディア (60%) に急接近する。スマートフォン向けなどの 3 社は損益が悪化しており AI 需要の取り込みで明暗が分かれた。



**□半導体装置各社、中国向け現地生産加速** 2026. 3. 10

**政府の国産化方針に対応**

ブイ・テクノロジーは中国向けの半導体製造装置を現地生産化する方針だ。2028 年度ごろの実施を検討する。イノテックも 26 年度から中国向けテスターについて現地生産に切り替える。中国では政府主導の下、製造装置の国産化が進む。中規模な半導体製造装置メーカーではグローバル市場と中国市場で戦略を分ける「二極化」が鮮明になってきた。



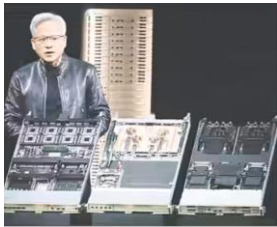
**□中国勢が積極投資 世界的メモリー不足、工場新設・拡張** 2026. 3. 12

**HBM開発を加速**

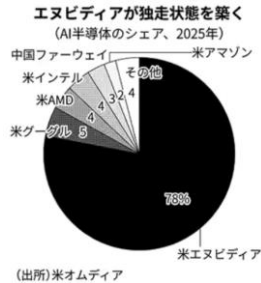
中国勢のメモリー投資がとどまることを知らない。NAND型フラッシュメモリーを手がける長江存儲科技 (YMT C) は 2026 年に新工場が稼働したのに続き、さらに工場を新設する準備に入った。また同社は広帯域メモリー (HBM) への参入も決めた。DRAMの長鑫存儲技術 (CXMT) も複数の投資を計画中。世界的にメモリー不足が深刻化する中、中国メモリーの雄は積極的な拡大策を取る。

YMT CとCXMTの特徴と投資計画		
企業名	長江存儲科技 (YMT C)	長鑫存儲技術 (CXMT)
種 類	NAND・DRAM (第3工場から)	DRAM
性 能	270層の3DNANDを実現、中国のスマホ向けで強み	DDR5を開発、HBMにも注力
直近の主な生産投資計画	26年に第2工場が稼働。第3工場が27年にも稼働観測	上海に新工場。第3期までの拡張を予定

**□エヌビディア、AI 半導体性能 35 倍「生産の仕事こなす」受注残 1 兆ドル** 2026. 3. 17  
 米エヌビディアは 16 日、新型の人工知能（AI）向け半導体を 2026 年後半に投入すると発表した。電力効率が従来比で最大 35 倍となる。業務を自動化する「AI エージェント」に必須な高効率半導体を拡充する。AI 半導体が依然好調で 2027 年までの受注残が 1 兆ドル（約 159 兆円）に達したことも明らかにした。

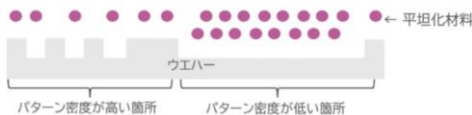


エヌビディアが披露した新型 AI 半導体（18日、米カリフォルニア州）



**□キャノンがナノインプリントを横展開、ウエハー平たん化で事業領域拡大**  
**インテルが技術評価、EUV 露光の精度向上に生かす** 2026. 3. 19  
 キヤノンはハンコを押すように半導体回路を造るナノインプリントリソグラフィ技術を、半導体ウエハーの平たん化に応用する手法を開発した。ウエハー表面の凹凸をナノレベルに抑えて EUV（極端紫外線）露光の焦点を合わせやすくし、先端半導体の歩留まりを高める。米 Intel やドイツ Merck グループもキャノンの手法に目を付け、技術評価を始めた。半導体ウエハーを平たん化する「Inkjet-based AdaptivePlanarization」(IAP) と呼ぶ技術を開発した。CMP（化学的機械研磨）やスピンコートと呼ぶ従来の平たん化技術ではウエハー表面の凹凸を 10nm 以下に抑えるのがかなり難しいが、新手法では凹凸を 5nm 以下に抑えられることを確かめた。下地層の材料や凹凸パターンが平たん化に与える影響も CMP やスピンコートに比べ抑えやすい。

① 下地パターンの疎密に最適化された配置で平坦化材料をジェットニング



② 平坦ガラス板でウエハー全面を一括押下



③ 紫外線で平坦化材料を硬化し、平坦ガラス板を剥離



図2 新手法は1回の押し当て工程で300mmウエハー全面を平たん化する (出所：キャノン)

**□ルネサス出資のインド後工程工場、26 年 9 月商用生産 悲願の半導体国産化** 2026. 3. 21  
 ルネサスエレクトロニクスが出資するインドの半導体後工程（パッケージング工程）工場が 2026 年 9 月に商用生産が始まる。地場財閥 Tata Group（タタ・グループ）や米 Micron Technology（マイクロン・テクノロジー）も同国で半導体生産に乗り出す。米 Apple が「iPhone」の製造を中国からインドへ移管するなど、半導体供給網の構築を後押しする動きが加速している。インド地場財閥 Murugappa Group（ムルガッパグループ）傘下の CG Power and Industrial Solutions（CG パワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ）が、インド西部グジャラート州に建設した半導体後工程の第 1 工場を稼働させる。運営を担うのは CG パワー子会社の CG Semi（CG セミ）だ。主力となる第 2 工場も建設中で、2027 年 10 月に商用生産を始める。

□マスク氏「AI 半導体工場を着工」 テスラとスペース X、テキサスに 2026. 3. 23

目標は1兆ワット、8割が宇宙向け

米電気自動車 (EV) 大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者 (CEO) は 21 日、人工知能 (AI) 向けの半導体を量産すると発表した。マスク氏が運営する宇宙開発のスペース X と、米南部テキサス州に大型工場を設ける。既に建設に入ったとするが、投資額や稼働時期、生産する半導体の回路線幅などは明らかにしていない。

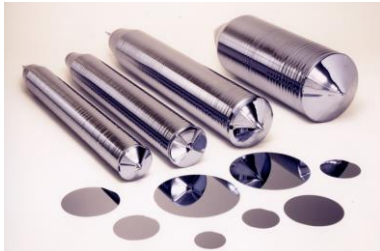
マスク氏が進めるAI半導体工場計画

名称	世界最大規模のチップ製造施設「TERAFAB」(テラファブ)
運営	テスラ、スペースX (傘下のxAI含む) がテキサス州オースティンに建設
概要	年間で1テラワット (演算能力) を生産。ロジック、メモリー、パッケージを1つの工場で生産
用途	自動運転車やヒト型ロボット、宇宙での太陽光発電や衛星向けを想定。8割は宇宙用途に

(注) 21日の発表内容に基づく

□企業フォーカス/SUMCO 先端半導体用に資源集中 2026. 3. 23

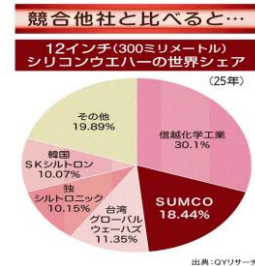
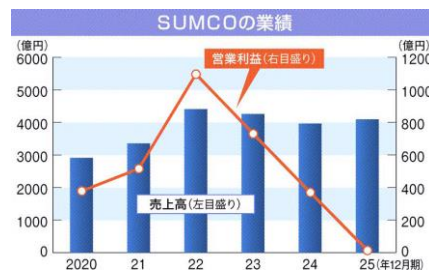
シリコンウエハー大手のSUMCOが経営体制を刷新し、一段の飛躍に挑む。27日付で龍田次郎副社長が社長に昇格し、橋本真幸会長兼最高経営責任者 (CEO) が取締役相談役に就く。橋本氏は近年、AI (人工知能) の普及などを踏まえ、先端半導体用300ミリメートルウエハーへの経営資源集中を図ってきた。龍田氏は先行投資の刈り取りとともに、社内でのAI活用や人材育成を加速して事業基盤を強化できるかが試される。



る。

SUMCO の製造するシリコンウエハー (手前)。

インゴット (奥) を厚さ1ミリメートル程度にスライスし、表面を丁寧に研磨、洗浄して完成する



□DRAM 価格、1年で8.8倍 AI 向け転換、供給大幅減 2026. 3. 23 半

導体メモリーのDRAMが一段と値上がりした。指標品の2月の大口取引価格は前月比15%高に決まり、1年前の8.8倍になった。韓国のサムスン電子などメモリー大手が、生産を終了し、人工知能 (AI) 向けにシフト。供給が大幅に減って、需要家となる家電メーカーなどはDRAMの調達難に陥り「製品をつくるほど赤字になる」と頭を抱える。



DRAMの種類と主な用途	
DDR3	家電、産業用機器、車載機器
DDR4	PC、家電
LPDDR4/4X	PC、家電、車載機器
LPDDR5/5X	PC、スマホ、車載機器
DDR5	PC、サーバー、データセンター
HBM	AIサーバー、データセンター
GDDR6	PC用グラフィックス、ゲーム

(注) エレクトロニクス産社の情報を基に作成

**□米ハイパ-ライトと UMC、光電融合向け「TFLN」量産 AI 省電力に 2026. 3. 26**

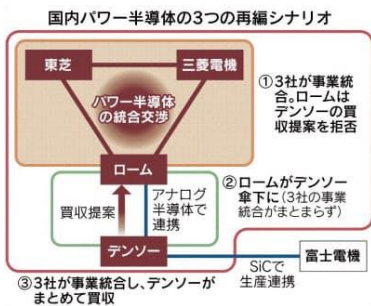
米新興の HyperLight（ハイパーライト）は次世代材料の薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）を用いた光通信半導体の量産体制を強化する。半導体受託生産（ファウンドリー）大手の台湾・聯華電子（UMC）と組み、従来と比べ口径の大きい半導体ウエハーを使うことで生産効率を高める。人工知能（AI）データセンター向けの高速度光通信市場を開拓する UMC 及び同社子会社の台湾 Wavetek Microelectronics（ウエーブテック）と提携したと 2026 年 3 月 12 日に発表した。

**□ローム・東芝・三菱電機、パワー半導体統合協議 世界 2 位連合へ 2026. 3. 27**

ロームと東芝、三菱電機の 3 社が、電気自動車（EV）やデータセンターの電力制御に使うパワー半導体事業の統合交渉を始める。統合が実現すれば合計の世界シェアが約 1 割で世界 2 位の連合が誕生する。ロームは東芝とパワー半導体事業の統合交渉を進めており、そこに三菱電機が合流する。統合の形態や出資比率などを含め今後の交渉で詰める。



**□パワー半導体再編 3 シナリオ デンソーと 3 社連合、株主価値競う 2026. 3. 31**

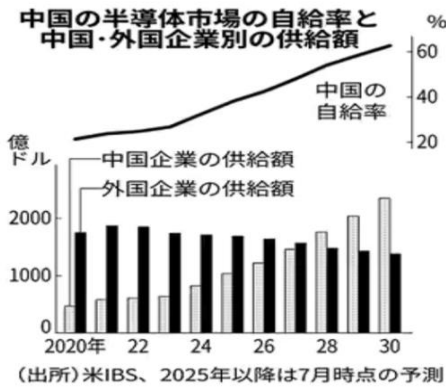


パワー半導体再編が大きく動き出した。ロームと東芝、三菱電機の 3 社が事業統合の協議入りで合意した。ロームにはデンソーも買収提案しており、今後については 3 つのシナリオが浮上する。

(1) 3 社事業統合、(2) ローム、デンソーの買収受け入れ、(3) 3 社統合後にデンソーが買収

**□中国半導体「自給率 8 割に」30 年目標、企業トップら提言 2026. 3. 28**

中国の半導体企業が技術開発や生産能力拡大を急ぐ。国際展示会で製造装置大手は相次いで新製品を発表した。半導体大手のトップら 13 人は 2030 年に国内自給率 80%をめざす提言をまとめ、米国を追い上げる。



□次世代半導体メモリー、初の表舞台 ソフトバンク・インテルの「サイメモリ」

2026. 3. 30

ソフトバンクと米インテルが組み、次世代メモリーの開発を目指す SAIMEMORY（サイメモリ）が 2 月、初めて表舞台に現れた。人工知能（AI）半導体に現在使われているメモリーは物理的な性能限界が迫り、画像処理半導体（GPU）の性能を十分に引き出せなくなりつつある。サイメモリは独自技術を武器にゲームチェンジを狙う。ラピダスのような国策会社化も選択肢に開発を急ぐ。サイメモリはソフトバンクが 30 億円を出資し 2024 年 12 月に設立した。インテルはメモリー技術を供与する。27 年度までに 80 億円を投じて試作品開発、29 年度に実用化を目指している。



サイメモリの「ZAM」は HBM を超える性能を目指す

■新技術、材料、電池

□「スマートレンズ」で眼圧測定

2026. 3. 3

早大が試作、緑内障を早期発見 28 年度にも臨床試験目に装着するタイプの情報端末「スマートコンタクトレンズ（SCL）」の実用化が近づいてきた。早稲田大学などの研究チームは緑内障などの早期発見が期待できる眼圧測定レンズの開発に成功した。2028 年度にも実際に人で安全性を確かめる臨床試験を始める。市販のソフトレンズに埋め込むタイプで、夜間や在宅でも眼圧の変動を測定できる可能性があり、早期の実用化を目指す。

スマートコンタクトレンズは様々な分野で  
応用が期待



コンタクトレンズと先端技術の融合の歴史	
1988年 ごろ	欧州の眼科医が目装着する視力矯正用 レンズを特許。論文名がコンタクトレン ズの語源となる
1940年代	ハードコンタクトレンズの開発が盛んに
61年	ソフトコンタクトレンズの製法が確立
2011年	米ワシントン大がコンタクトレンズに L E D を搭載
13年	ベルギーのゲント大が曲がる液晶を搭載
26年	早稲田大が眼圧を測定する技術を開発
32年	スマートコンタクトレンズの世界市場が 約190億ドル規模に成長見込み

SCL はディスプレイやセンサーといった超小型電子部品を内蔵したコンタクトレンズで、情報をレンズの視界に表示する拡張現実（AR）向けの技術や生体情報をセンサーで読み取る医療用途など様々なタイプの製品開発が世界で進む。導電性ポリマーと合成樹脂による多層構造の素材で構成されている。

**□オキサイド、量子向けレーザー光源参入 変換効率 50 倍**

2026. 3. 9

オキサイドは量子コンピューターに使うレーザー光源市場に本格参入する。第1弾として量子コンピューターの一種である「中性原子型」向けに特化した新型レーザー光源を開発。波長302ナノメートル、出力0.5ワットの高出力を実現し、連続5000時間の安定稼働を可能にした。波長変換効率は一般的に1%とされる中、50倍と大幅に高めた。3月中にも本格的な販売を開始。海外依存度が高い量子コンピューター主要部品の国産化を後押しする。

**□熱で消える指紋を検出**

2026. 3. 17

理研など、無機物を目印に 火災現場の捜査に光理化学研究所と兵庫県立大学は火災現場や銃の薬きょうに残るわずかな指紋を特殊な X 線で検出する技術を開発した。熱で変質しやすい有機物を目印にする従来の方法では発見が難しい指紋を見つげられる。多数の標本で精度を確かめ 2~3 年後に実用化を目指す。



指紋に関する主な歴史	
1880年	英ヘンリー・フォールズ氏が指紋で科学的に個人を識別できるとする研究を発表
1901年	英国で指紋を使う犯罪捜査を開始
11年	日本の警視庁も指紋を捜査に活用
82年	警察庁が自動指紋照合システムを導入
2025年	メイヌース大が薬きょうに残る指紋を可視化する技術を論文で掲載
26年	理研と兵庫県立大がナトリウムを目印に指紋を検出する技術を論文で発表
34年	指紋鑑定を含む法科学技術の世界市場が25年比で2倍超に

(出所) 取材に基づき作成

**□フォトニック結晶レーザーでシリクスを切断、半導体製造も視野 光を操る日本発の技術**

2026. 3. 22

**フォトニック結晶レーザーが切り拓く世界**

**加速する実用化への動き**

- 2024年12月に設立した「京都大学フォトニック結晶レーザー研究拠点」が、社会実装の促進に向けて基礎研究と実用化の両方を推進し、フォトニック結晶レーザーからのレーザー光をタンクに当てると、先端的な半導体の製造に欠かせない露光装置に用いる極端紫外線(EUV)を出すことができる
- 地上実証で約40%の損傷の減りに成功し、約28万、離れた月との光通信を目指す
- 人工衛星に搭載するため、装置を軽量化
- 光通信は電波での通信よりも大容量データの送受信に適している
- レーザー光のバリエーションで障害物などを検知するライダーは、自動運転を行う自動車にとって「目」に相当する
- ライダーで見た人間の様子

**フォトニック結晶とは**

- 京都大の野田進特別教授が四半世紀前に開発した日本発の技術
- 光の屈折や反射、波長などを工夫して、光の進み方を自在にコントロールできる
- 電子回路が電流で情報を伝送するのと同じように、フォトニック結晶は光で情報を伝送する

**フォトニック結晶レーザー**

- フォトニック結晶レーザーは、シリクスを切断する際に、従来のレーザーよりも高い精度でレーザー光が一点に集まる性質を有する
- 小型かつ省エネで、従来の大型レーザーに匹敵する高い精度でレーザー光が一点に集まる性質を有する
- 2019年に実現した「量子格子構造」が高精度を、2025年に発表した「複合変調構造」が多種多様なレーザー光の発射を、それぞれ実現した

**2重構造構造**

**複合変調構造**

**金属加工**

- フォトニック結晶レーザーでシリクスを切断する様子
- 切断されたシリクス

**宇宙空間での光通信**

- 地上実証で約40%の損傷の減りに成功し、約28万、離れた月との光通信を目指す
- 人工衛星に搭載するため、装置を軽量化
- 光通信は電波での通信よりも大容量データの送受信に適している

**ライダー**

- レーザー光のバリエーションで障害物などを検知するライダーは、自動運転を行う自動車にとって「目」に相当する
- ライダーで見た人間の様子

**Kyoto Univ.**

「複合変調構造」で開発した最先端レーザー光源「ナノフォトニック」の開発者 野田進特別教授

日本で誕生し、光を自在に操る「フォトニック結晶」を用いたレーザーの実用化に向け、動きが加速している。近年相次いだブレークスルーにより、小型かつ省エネで大型レーザーに匹敵する性能を実現。金属加工や自動運転、宇宙空間での光通信などに加え、先端半導体の製造でも活用が期待される。研究レベルは欧米や中国に先行し、一昨年12月には開発者である京都大の野田進特別教授（光量子電子工学）が中心となって、経済安全保障に配慮しながら研究現場と実用化を橋渡しする研究所が設立された。

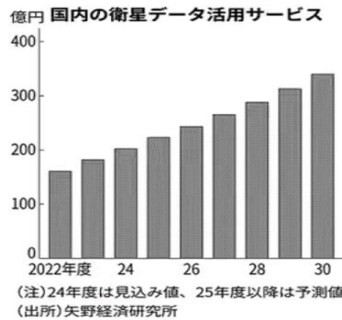
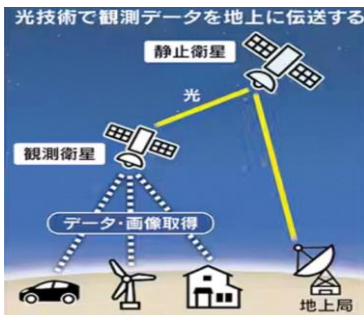
フォトニック結晶は、光の屈折や反射、波長などを利用し、ナノメートル（ナノは10億分の1）レベルで光の進み方を自在にコントロールできる人工結晶だ。野田さんが四半世紀前に世界で初めて実現した。

**衛星データ、即時伝送 28年度にも打ち上げ**

2026. 3. 23

**NTTとスカパーJSAT 地表や気象、安保に需要**

NTTとスカパーJSATは2030年までに、人工衛星で観測した地表や気象などのデータを光技術により高速・大容量で伝送するサービスを始める。米国・イスラエルとイランの軍事衝突などを背景に安全保障分野で衛星データの需要は高まる。民間主体のサービスとしてはほとんど例がなく、日本勢による衛星ビジネスが広がる契機となる。



**薄い・曲がる太陽電池、商用化 積水化学系、フィルム型は国内初**

2026. 3. 31

次世代の「ペロブスカイト太陽電池」の販売を積水化学工業の子会社、積水ソーラーフィルムが始めた。薄くて曲げられるフィルム型で、これまで太陽電池を設置できなかった場所でも発電できるようになる。同社によるとフィルム型で商用化されるのは国内初。



**カーエレクトロニクス**

**自動運転の「目」、Tesla方式に勢い カメラとAIのみで制御**

2026. 3. 6

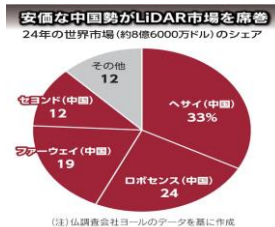
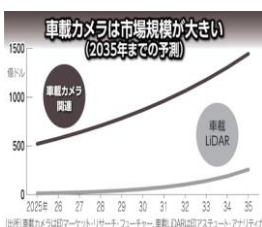
自動運転車の「目」を担う技術の勢力争いが激しくなってきた。カメラだけで運転を制御する米Teslaの方式を採用する企業が増え、高精度センサーとカメラを併用する主流派を追い上げている。背景には人工知能(AI)の急速な進化がある。センサー無し的方式が広がれば関連産業にも影響を与える一方、安全性の確保などが課題となる。



人が介さない「レベル4」でTesla方式広がる

Tesla(米)	自動運転タクシー車両「サイバーキャブ」を今春に量産
シャオペン(中国)	自動運転タクシーを26年に3車種投入。AI性能向上で対応
イマジリー(イスラエル)	豊田通商と組み、日本で自動運転バスによる実証実験
ストロビジョン(韓国)	将来的にLiDARが不要になるカメラ技術の開発
チューリング(日本)	デンソーなど出資。カメラのみで自動運転AIシステム開発

ミニコンプレックスの中で自動運転車を開発するLiDAR(赤外線)から切り替えた(1月)



LiDAR関連メーカーは苦戦

ルミネア(米)	時価総額は一時1兆円超え。自動運転の普及遅れや価格競争で25年に破綻
小糸製作所(日本)	車載向けの新規投資を25年に凍結。海外自動車メーカーの採用見送り
モービルアイ(イスラエル)	次世代LiDARの内製化計画を24年に中止。外販品のコスト低下

小糸製作所が開発したLiDAR

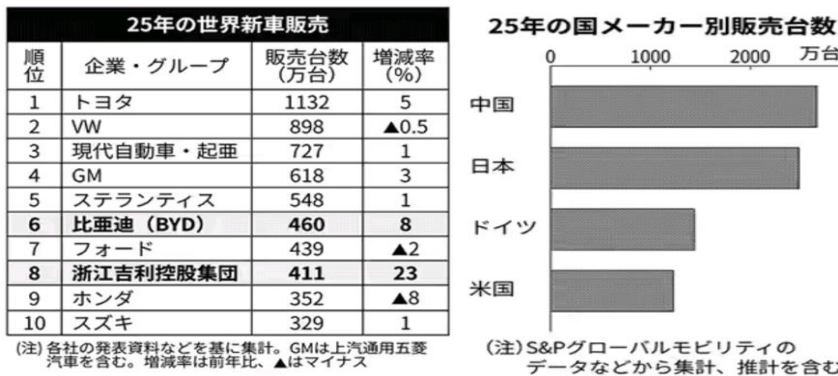
グラフィックス 細井 桃子

**□ホンダの通期見通し、当期赤字最大 6900 億円 EV 開発中止で減損** 2026. 3. 13

ホンダは、2026 年 3 月期の連結当期損益が最大 6900 億円の赤字（前期は 8358 億円の黒字）になる見通しだと発表した。25 年 11 月公表時は 3000 億円の黒字としていた。当期赤字は連結決算の開示を始めた 1977 年以降初。

**□世界新車販売、中国が首位 昨年、日本上回り初 足元は鈍化** 2026. 3. 22

2025 年の世界新車販売ランキングで、中国車が総販売台数で日本車を上回り首位となった。日本車の首位陥落は 00 年以降初めて。比亞迪（BYD）と浙江吉利控股集团が日産自動車とホンダの販売台数をそれぞれ上回った。足元で中国市場の伸びは鈍化してきている。中国車の勢いが続くかどうかは、欧州や東南アジアなど海外の開拓にかかっている。



**□ソニー・ホンダ、EV 開発を中止 米の政策転換で誤算** 2026. 3. 26

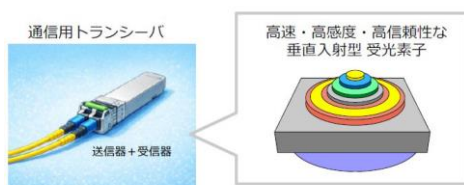
ソニーグループとホンダが共同出資するソニー・ホンダモビリティは 25 日、電気自動車（EV）の開発と販売を中止すると発表した。米国の EV 需要の減少を受けて、生産を委託するホンダが EV 戦略を抜本的に見直し、事業の継続が困難になった。

**■通信**

**□モバイル見本市「MWC」、AI 一色 ドコモは個人用 AI エージェント** 2026. 3. 2

世界最大級のモバイル関連見本市「MWC2026」が 2 日、スペイン・バルセロナで始まった。開幕に合わせて、NTT ドコモは人工知能（AI）が自律的に作業をする AI エージェントの個人向けサービスを発表した。KDDI は AI を活用した人型ロボットを開発する。MWC は今年 20 回目となる。当初、モバイル（携帯）通信技術が競争軸だったのが通信と AI の融合など AI 技術にシフトしてきた。

**□動作速度 200 ギガヘルツ超 NTT が高速光通信向け受光素子** 2026. 3. 13



開発した受光素子のイメージと想定される利用シーン

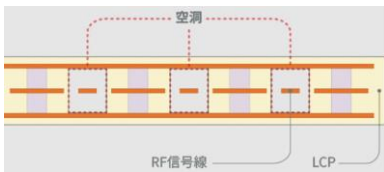
NTT は毎秒 3・2 テラビット級の高速光通信に向け、動作速度 200 ギガヘルツ超で、実用レベルの信頼性を持つ受光素子を開発した。データセンター内をつなぐ光通信に用いる 1310 ナノメートルの波長帯で世界最高の速度と感度を達成。200 ギガ—400 ギガボー（1 秒当たりのシンボル数）の光トランシーバーの基盤技術として、NTT イノベティブデバイス（横浜市神奈川区）が製品化する。

**□村田製作所が 6G 狙う樹脂基板、中空構造で損失 3 割減**

2026. 3. 19

スマホに向けたメトロサークの後継、注目の高周波数帯 FR3 で先手

村田製作所は電子回路向けに、中空構造を導入した樹脂多層基板の量産を始めたと発表した。2030 年ごろの実用化が見込まれる 6G（第 6 世代移動通信システム）のスマートフォンや AR（拡張現実）端末に向ける。柔軟性が高く機器設計の自由度を高められることに加え、中空構造の導入により誘電率を下げ伝送損失を抑えた。「ULTICIRC（アルティサーク）」と呼ぶ樹脂多層基板の量産を始めた。従来の主力製品「MetroCirc（メトロサーク）」の後継に当たり、高周波信号の伝送損失をメトロサークと比べて約 3 割減らした。誘電率（Dk）を従来は実現が難しかった 2 未満に下げたことが特徴で、基板を中空構造にすることで実現した。基板の曲げが必要な箇所には中空構造を設けず、強度や形状保持性を保てるようにしている。



樹脂多層基板に中空構造を設け伝送損失を下げる

**□ソフトバンク・AGC、6G 基地局アンテナ実証 消費電力最大 8 分の 1**

2026. 3. 20

ソフトバンクは 19 日、高周波数帯の電波を用いる第 6 世代通信（6G）向けに新たな構成の基地局アンテナ「機能性ビーム成形レンズアンテナ」を AGC と共同開発し、屋外での実証に成功したと発表した。ソフトバンクの通信エリアやアンテナビームの設計技術と、薄い基板上に微細な構造を並べることで電波の進行方向や広がりやを自在に調整できる AGC のメタサーフェスレンズ技術を組み合わせた。アンテナ構成の簡素化により、消費電力を従来比で最大 8 分の 1 に減らせる。

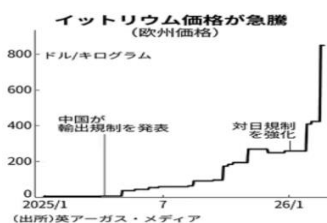
**■環境/エネルギー/レアアース/SDGs**

**□イットリウム、1 年で 140 倍 半導体・防衛向けレアアース 中国の輸出規制で急騰**

2026. 3. 6

レアアース（希土類）の一種で、半導体や防衛用途で使われるイットリウムの価格急騰が鮮明だ。中国がレアアースに対する輸出規制を発動して 1 年近くたつが、イットリウムへの影響は甚大で 1 年で価格は約 140 倍に達した。2026 年に入って打ち出された対日輸出規制が一段と供給懸念を強め、価格高騰に拍車がかかっている。

イットリウムは幅広い用途で使われる

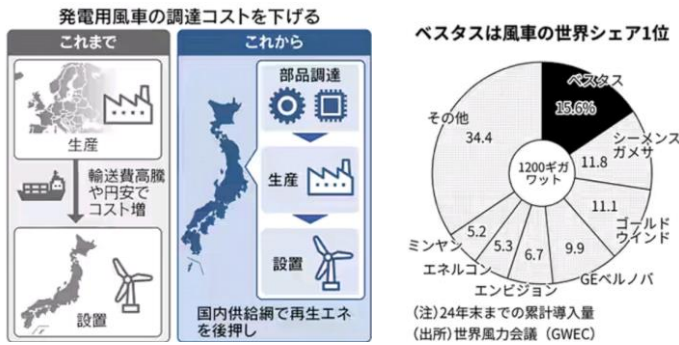


**□洋上風車大手、日本に工場 欧州ベスト**

2026. 3. 9

国内供給網、調達コスト下げ 再エネ拡大に追い風

洋上風力発電に使う風車の世界最大手、ベスタス（デンマーク）は 2029 年度までに日本国内に工場を設ける。洋上風力の拡大が見込まれる日本やアジア各国の需要を取り込む。日本は風車を輸入に依存してきた。国内サプライチェーン（供給網）を整備し将来的に調達コストが下がれば、洋上風力の採算性が高まる。



**温暖化対策、AI が指南 海洋機構、「特化型」を開発 猛暑や豪雨など備え**

2026. 3. 10

海洋研究開発機構（JAMSTEC）は気候変動への対応に特化した人工知能（AI）を開発した。温暖化が進んだ将来の気温や降水量を予測したデータを読み込む機能を世界で初めて搭載し、利用者の質問に高精度で答えるようにした。試験運用を経て 2028 年ごろまでの実用化を目指す。



**企業動向、製品動向**

**中国ロキッド、スマート AI グラスをマクアケで先行発売 応援購入初日に 1 億円突破**

2026. 3. 4



マクアケで先行発売した「スマート AI グラス Rokid」

中国・Rokid（ロキッド）が応援購入サイト「Makuaake（マクアケ）」で2月26日に先行発売した「スマートAI（人工知能）グラス Rokid」の応援購入総額が開始初日で1億円を超えた。「AIと拡張現実（AR）をフル装備したスマートグラス」として北米や中国では既に販売。既存製品と比べ高性能の同製品がどこまで実績を積み上げられるかは、スマートグラスの普及にとっても試金石になる。価格は3月3日時点で消費税込みで8万4990円から。

**アリババ、AI スマートグラス 年内にも海外展開**

2026. 3. 5

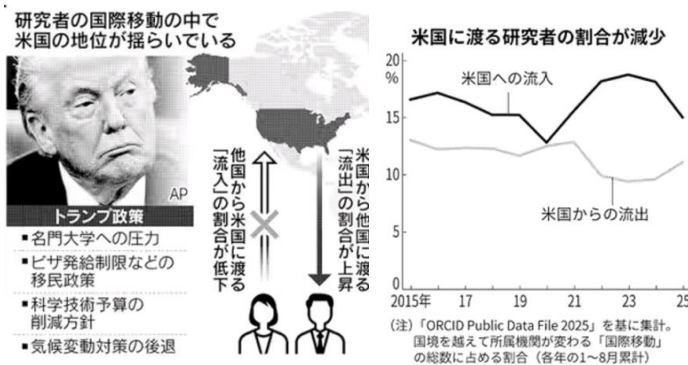
中国ネット通販最大手のアリババ集団は、2026 年内にも生成 AI（人工知能）に対応したスマートグラス（眼鏡型端末）を海外展開すると発表した。AI モデルやアプリと同じ「千問（Qwen）」のブランドで売り出す。中国メディアによると、AI に対応したリングやイヤホンなどの端末も拡充する計画という。

□スズキ、全固体電池事業に参入 カナデビアから事業譲渡 2026. 3. 4

スズキは次世代の電気自動車（EV）で期待される全固体電池事業に参入する。4日にカナデビアと事業譲渡の契約を結んだ。全固体電池は航続距離を延ばしやすいため、次世代電池の本命とされている。スズキはカナデビアの技術や実証設備を引き継ぎ、実用化に向けた研究を進める。事業譲渡日は7月1日を予定する。

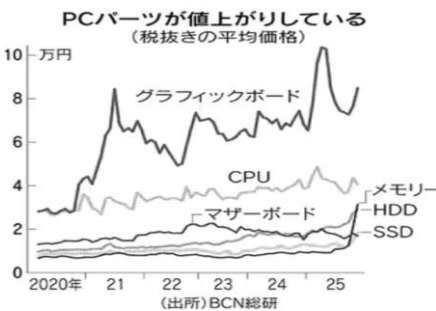
□研究者の国際移動、米国の流出シェア 11%に上昇 気候変動分野など 2026. 3. 7

トランプ米政権下で大学などの研究者が米国を避ける動きが広がり始めた。国際データベースを分析すると、2025年1~8月に国境を越えて移動した研究者のうち、米国の流出シェアは11%に上昇し、流入シェアは15%に低下した。気候変動分野などの学者が欧州に移動している。大学への圧力など過激な政策の下、米国の科学超大国としての地位が揺らいでいる。



□PC パーツ高騰、DRAM は1年で3倍以上に 寡占・AI 優先で品不足 2026. 3. 7

パソコン（PC）のパーツ価格が高騰している。家電量販店や専門店などでは、2025年の1年間で3倍以上に値上がりするパーツも出てきた。米国・韓国などの企業による市場寡占と、各社の人工知能（AI）データセンター向けの供給優先といういわば「二重苦」が、一般消費者向けの製品不足と価格上昇を引き起こしている。



□サムスン 他人に画面見られない新型スマホ 2026. 3. 12

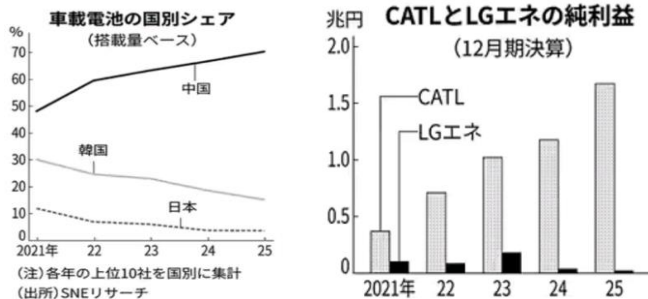
韓国サムスン電子は、他人から画面を見られないように設定できる新型スマホ「ギャラクシー S 26」を12日に発表する。見る人が真正面にいる時だけクリアに見え、他人に見せたくないアプリや通知を指定できる。こうしたスマホは世界初だとしている。

□中国 100社以上がペロブスカイト開発 CATL・BYDも研究 2026. 3. 10

ペロブスカイト太陽電池の量産で先行するのが中国企業だ。スタートアップの極電光能（ウトモライト）やシリコン型太陽電池大手の協鑫集団（GCL）の傘下企業などが大規模な生産ラインを稼働させた。中国では100社以上がペロブスカイト太陽電池を開発している。

**EV 電池の中国勢シェア 7 割に、CATL 最高益 米国で苦戦の韓国勢に差** 2026. 3. 15

電気自動車（EV）向けの電池で中国企業のシェアが伸びている。2025 年は 7 割を超え、21 年の 5 割弱に比べ寡占が進んだ。世界の EV 需要が減速するなかでも、最大手の寧徳時代新能源科技（CATL）は中国や欧州で受注を拡大し最高益を更新。主力の米国向けが苦戦する韓国勢と差を広げる。



**PC・スマホ高くなるかも**

2026. 3. 17

**メモリー供給不足で高騰 AI 需要でデータセンター増**

パソコンやスマホに組み込まれるメモリー半導体が高騰、背景には AI ブームによる供給不足がある。春の新生活を前にパソコンやスマホの値上げが進む可能性がある。

**孫氏の「大風呂敷」再び ソフトバンク G が 80 兆円計画 米で AI 投資、日米 21 社参画**

2026. 3. 22 ソ

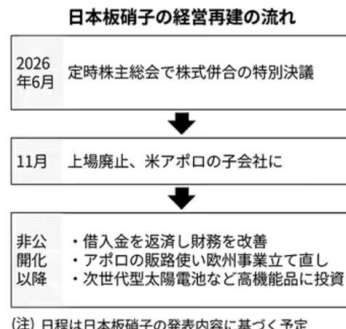
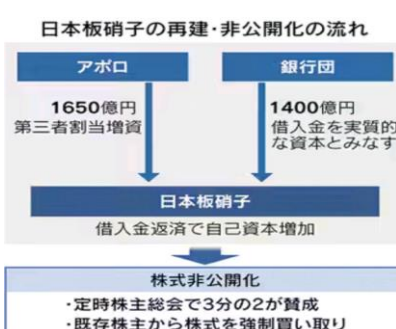
ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長は 20 日、米中西部オハイオ州での 5000 億ドル（約 80 兆円）の投資を表明した。データセンターを中心に電力や通信など幅広い産業が集積し「1 カ所の投資として人類史上最大」（孫氏）となる。トランプ米大統領との親交をもとに日米の官民を巻き込んで、再び「大風呂敷」を広げた。

25年1月	全米にAIインフラ建設の「スターゲート」発表、4年で5000億ドル投資
4月	米オープンAIに追加出資発表、25年末までに最大300億ドル
8月	米インテルに20億ドル出資発表
11月	AI半導体の米アンベア・コンピューティングを65億ドルで買収完了
12月	米投資会社デジタルブリッジ・グループの買収を発表
26年2月	オープンAIに300億ドル追加出資発表、1社に10兆円規模を集中投資
3月	米中西部オハイオ州でデータセンター開発、1カ所に5000億ドル投資

**日本板硝子、再建へ高機能磨く**

2026. 3. 25

太陽電池や次世代半導体向け 11 月にも株式非公開化日本板硝子は 24 日、投資ファンドや銀行団から支援を受け 2027 年 3 月期下半期に株式を非公開化すると発表した。非公開化が実現すれば、ファンド傘下で不振の要因となっている海外事業の立て直しを進めるほか、債務を圧縮し戦略投資にも乗り出す。ペロブスカイト太陽電池や次世代半導体向けガラス素材の成長が今後の浮沈を左右する。



2000年	英ビルキントンの株式約10%を取得
01年	ビルキントンの保有株比率を約20%に引き上げ持ち分法適用会社に
06年	約30億ポンド（約6160億円）でビルキントン買収
08年	ビルキントン出身者が社長に就任。その後1年あまりで退任
10年	米デュポン出身者が社長に就任。その後2年未だで退任
12~13年	日本人社長のもとで海外を中心に工場閉鎖や約6000人の削減を実施
26年3月	銀行団と米ファンドから支援受け株式非公開化による再建策を発表

□ファナック、米に新工場 143 億円投資、AI ロボ対応

2026. 3. 24



ファナックはフィジカルAIの生産現場への導入を加速させる

ファナックは23日、9000万ドル（約143億円）を投じて米ミシガン州にロボット工場と物流センターを新設すると発表した。建屋の延べ床面積は約7万8000平方メートルで新たに用地を取得した。2027年末の完成を見込む。米国における製造業の国内回帰やAI（人工知能）がロボットを自律的に動かす「フィジカル（物理）AI」、デジタルツインなど北米で高まる自動化需要に対応する。

□中国・邁為科技、ペロブスカイト太陽電池製造装置の新工場 800 億円投資 2026. 3. 24

中国で先端製品の生産設備を手掛ける邁為科技はペロブスカイト太陽電池向け製造装置の工場を新たに設ける。投資額は35億元（約800億円）。発電効率の高い次世代品として期待が集まるペロブスカイト太陽電池は中国で量産開始が相次いでおり、市場の伸びを取り込む。江蘇省蘇州の国有地の使用権を近く取得する。広さは9万平方メートル。

□廉価スマホでも予算圏外？ メモリ急騰、本体価格の9割分 採算合わず値上げ相次ぐ

2026. 3. 26

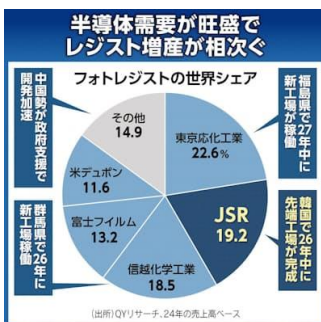
半導体メモリーの価格高騰がスマホの生産コストを押し上げている。メモリーの世界大手が人工知能（AI）向けの供給を優先した結果、スマホ向けが品薄になった。低価格帯スマホは、メモリー価格が1年で4倍に膨らむ見通しで、試算上は販売価格の9割を占める。原価にスマートさはなくなり、安い機種は少しずつ店頭から姿を消していくかもしれない。



□JSR、半導体材料に全集中 売上高2~3倍へ、後工程向け伸ばす 業界再編意欲は後退

2026. 3. 27

政府系ファンドに買収されて株式を非公開化した JSR が、主力の半導体材料事業に経営資源を集中させる。2030年度の事業売上高を非公開前の2~3倍に増やす計画だ。稼ぎ頭のフォトレジストのほか、後工程向けなどの製品を伸ばす。稼いだ利益は巨額の負債の圧縮などに充てるが、非公開化の「大義」だった業界再編への意欲は後退している。



□アップル 50年、情報を民主化

2026. 3. 30

革新の旗手から既得権者に成熟 AI 端末、テック競合先手米アップルが4月1日、創業から50周年を迎える。「iPhone」や「Mac」など現在、世界で使われている端末は計25億台にのぼる。故スティーブ・ジョブズ氏は一部の専門家向けだったコンピューターを一般消費者にも広げ、情報の民主化を果たした。高性能コンピューターの開発競争は半導体の進化を後押しし、人工知能（AI）時代の礎ともなった。



AI端末にテック企業が野心

**オープンAI** | 米新興企業io Productsを約64億ドルで買収、2027年以降にAI向け端末を発売見通し

30年前に自身がアップル製品で感じた喜びや驚きを実現する

サム・アルトマン CEO

企業買収

元アップルのデザイン幹部 ジョニー・アイブ氏

**メタ** | 25年に小型ディスプレイを備えた眼鏡型端末を発売、AI機能を搭載

スマホの次のコンピューティング基盤に

マーク・ザッカーバーグ CEO

(注)写真はすべてロイター

**クック氏の後継はターナス氏が最有力**

ハードウェアエンジニアリング担当 **ジョン・ターナス氏**

最高幹部では若い50歳。協調性がある。大学時代は水泳選手

サービス・ヘルス担当 **エディ・キュー氏**

音楽やハリウッドでも顔が広い。NBA好き

ソフトウェアエンジニアリング担当 **クレイグ・フェデリギ氏**

髪形がトレードマーク。ジョー・マンでファンが多い

(注)3氏はシニアバイスプレジデント

かつての候補は退任 **ジェフ・ウィリアムズ氏 (前COO)**  
**リサ・ジャクソン氏**

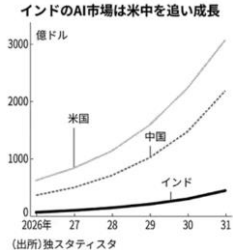
グラフィックス 武井由実<

■ AI、生成AI

□インドのAI、7兆円市場開拓へ号砲 教育や医療で「カエル跳び」 政府も支援、米中追う 2026. 3. 6

インドで人工知能（AI）の普及が加速している。教育や医療など様々な分野の課題解決に向けて導入が広がる。AI 関連市場は今後5年間で6倍に膨らみ、米中などを追う7兆円規模になる見通し。一足飛びに革新が起きる「リープフロッグ（カエル跳び）」の実現を目指し、国内外のスタートアップやテック大手が商機を探る。

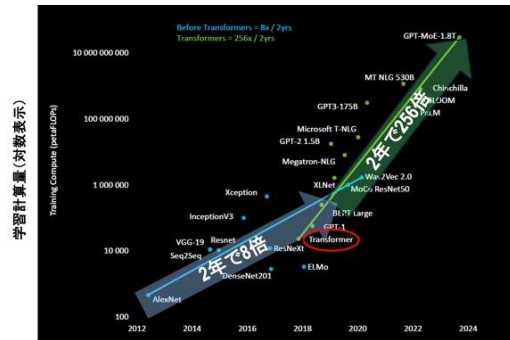
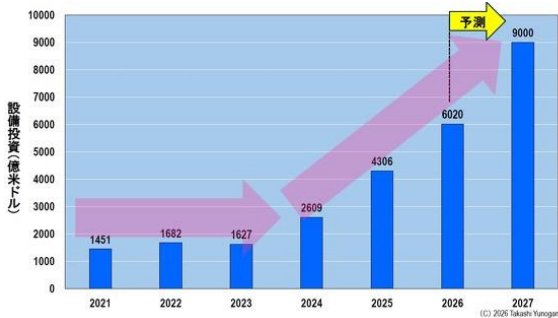
社名	分野	特徴
サルバム AI	大規模言語モデル	・現地語に強み ・個人識別制度と連携
コンベンションニアス	教育	・1.5億人の学習支援 ・個別学習で数学の効果2.3倍
エカケア	医療	・診察音声から電子カルテ作成 ・オフラインで遠隔地対応
デハート	農業	・12州で180万人超の農家支援 ・害虫管理や種まきアドバイス
アダラットAI	法務	・法廷記録文字起こし ・主要州の地方裁判所に導入



□AI の競争軸は半導体から電力へ——日本の戦略の「死角」に 2026. 3. 12

データセンター投資が示す異変 「半導体の進化」が電力増に追い付かない

AI の競争軸は、半導体から電力へと移りつつある。なぜなら、AI に必要な計算能力の拡大が、半導体の性能向上よりも速いペースで電力需要を増大させているためである。これは、日本の半導体戦略において見落とされがちな「死角」でもある。2021年に1451億米ドルだった世界のデータセンター投資は、2027年に9000億米ドル超に達する見込みだ。しかし、今この巨額投資の出発点になっているのは、GPUなどのAI半導体の調達計画ではない。「どれだけの電力を確保できるか」である。



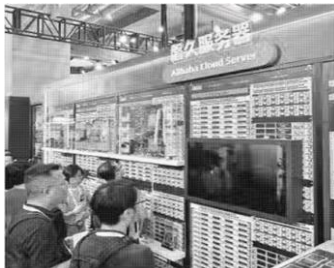
データセンターへの設備投資の推移 学習に必要な計算量の指数的増大（「2年で8倍」から「2年で256倍へ」と加速）

□フィジカルAIに優先支援 強さの先にある「進化」に期待 2026. 3. 20

高市早苗首相が掲げる「日本成長戦略」において、AI（人工知能）がロボットや機械を自律的に動かす「フィジカルAI」を優先的に支援することが決まった。わが国の強みとされるロボットや工作機械にAIを実装し、新たなシステムとして中核産業化を狙う。政府はAIロボットで米中と並ぶ第三極を形成し、2040年には世界シェアの3割強を目指すことを明記した。国際競争力の低下が久しいわが国ながら、工作機械などの資本財は高い優位性を保持している。強さの先にある「進化」に期待する。政府が定めるAIや半導体など17の戦略分野の中で、特に優先支援する61の製品や技術の一つとしてAIロボットが位置付けられた。世界的な市場拡大が見込まれ、40年には60兆円に達すると予想。その3割超である20兆円を獲得するような支援を進める。

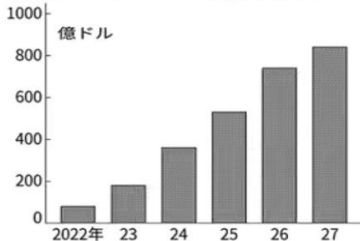
□中国ネット、AI 投資 13 兆円 来年の4社「AI エージェント」注力 2026. 3. 24  
アリババ、年 40%超える成長 テンセント、開発投資 8000 億円

中国のネット大手がデータセンターなどの設備投資を積み増す。アリババグループなど大手4社合計の投資額は2027年に25年比6割増の13兆円規模になる見込み。人工知能(AI)の関連需要を取り込むための基盤の整備を急ぐ。投資が先行して収益の悪化につながる懸念もある。



アリババグループのクラウドサーバーの展示 (2025年、浙江省杭州市)

中国ネット大手4社の設備投資額



(注)アリババ、テンセント、バイトダンス、百度の4社。25年以降は予測

■その他

□(全人代2026)中国経済、強まる明暗 新興テック発展、EVは淘汰 2026. 3. 5

中国の国会にあたる全国人民代表大会(全人代)が5日、開幕する。ハイテク分野では「自立自強」に邁進(まいしん)する一方、足元では経済の減速傾向は鮮明になっており、過当競争による企業の疲弊も深刻化している。習近平(シーチンピン)指導部がどのような政策方針を示すかが注目される。

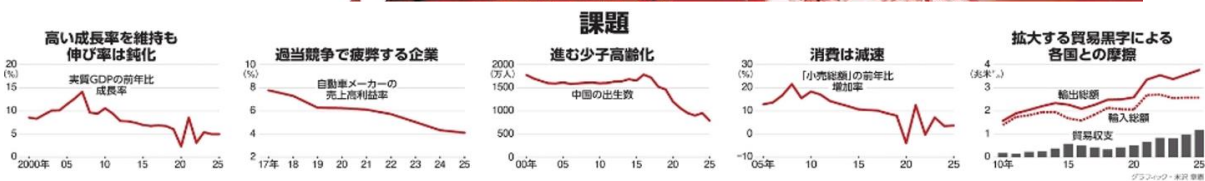
**中国が目指す未来と課題**

**経済成長**  
2035年までに国民1人当たり国内総生産(GDP)を中等先進国並みに

**内需拡大**  
内需を経済成長のエンジンとし、トランプ関税など外部環境に左右されない発展モデルを構築

**産業育成と自立自強**  
エレクトロニクスや宇宙産業、人工知能(AI)産業などを育成し、重要な科学技術で他国に勝らない[自立自強]の強国

**ハイレベルな対外開放**  
多角的な貿易体制を維持し、貿易摩擦などに柔軟に対応する「一帯一路」の建設



□中国、成長維持へ財政頼み 26年目標「4.5~5%」に下げ 2026. 3. 6

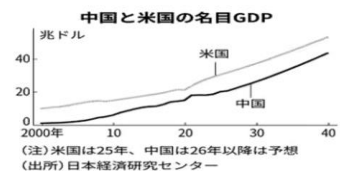
中国で国会に相当する全国人民代表大会(全人代)が5日開幕した。李強(リー・チャン)首相は2026年の実質経済成長率の目標を「4.5~5%」と定め、3年ぶりに引き下げた。不動産不況による内需不足が深刻となるなか、成長の維持へ財政頼みの状況が続く。

政府活動報告の主な経済政策の内容

財政	■ 財政赤字比率を4%前後に据え置き
金融	■ 「適度に緩和的」な金融政策を維持 ■ 国有大手行に資本注入
消費	■ 耐久財の買い替え補助金 ■ 利子補給などに特別資金
不動産	■ 不動産市場の安定に力を入れる
雇用	■ 失業率目標5.5%前後に据え置き

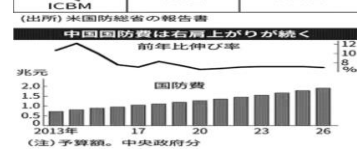
新たな5カ年計画の主なポイント

35年に1人当たりGDPを20年比2倍に
高性能半導体の生産能力の向上
AIのソフトや半導体の開発を強化
台湾との関係で主導権を掌握
レアアースの優位性を強化
雇用創出など通じ消費振興



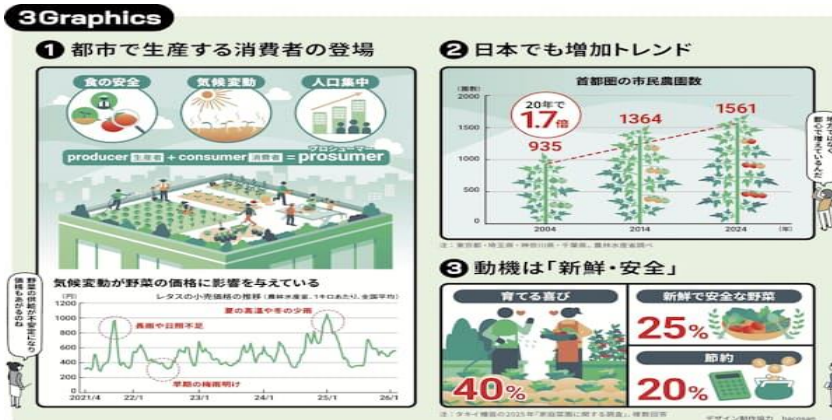
中国は軍用機やミサイルを増強する

	2025年	24年
地上兵力	104万人	104万人
空母	3隻	3隻
戦闘機	2200機	1900機
爆撃機	550機	500機
ICBM	550基	500基



**野菜は「買う」から「作る」時代 食の安全や供給不安が後押し 2026. 3. 10**

欧米で都市型の家庭菜園が注目されている。気候変動で野菜の供給が不安定になり、食の安全性への関心も高まっているためだ。ニューヨークやパリは住民が交流するコミュニティーづくりや生態系の再生という観点から、都市型菜園を支援している。



**論文数で世界3位目指す 政府が科学技術計画、5年で60兆円投資 2026. 3. 27**

**安保と連携を初明記 産官学で軍民両用研究**

政府は27日の閣議で、2026年度から5年間の科学技術政策の指針となる「科学技術・イノベーション基本計画（科技計画）」を決定した。被引用数トップ10%の論文数に関し「10年以内に世界第3位に復権する」との目標を明記した。国の科学技術関連の投資目標を60兆円と定めた。初めて「国家安全保障との有機的な連携」を掲げ、デュアルユース（軍民両用）技術の研究開発を前面に打ち出した。

科学技術計画の主なポイント		科学技術と安全保障が密接になってきた	
研究力	大学の運営費や科研費を大幅に増額し、研究力を強化	2015年	安保技術研究推進制度 防衛装備庁が研究テーマを公募、大学や企業が参加
国家戦略技術	AIや半導体、核融合、宇宙など6分野を指定し重点支援	22年	経済安全保障推進法 AIや量子、宇宙などを「特定重要技術」に指定。研究開発に補助金
安全保障	デュアルユース技術の研究推進		K Program創設
大学改革	・人事制度や組織体制の見直し ・海外研究者の誘致 ・理系育成へ規模「適正化」	25年	半導体や量子などの研究開発～実用化まで国が伴走支援
成果指標	・トップ論文「世界13→3位」へ ・政府60兆円、官民180兆円投資		国家戦略技術の指定
		核融合や通信など6分野を指定。税制優遇などで支援	
		26年	重要技術戦略研究所（仮称）設置 特定重要技術の分析、研究開発

文部科学省によると、40年には大卒・院修了の理系人材は124万人不足する見通しだ。首都圏の大規模私立大について文系学部偏らず、理系学部を拡充するよう促す。看護や介護分野といった分野は地方の生活基盤に欠かせない。これらの専門職を育成する教育環境の充実も打ち出した。

以上

**図表、写真 の出所一覧 (WEB、電子版を含む)**
**■ディスプレイデバイス (液晶・有機EL 他)・タッチセンサー・部材**

- ・ 2026. 3. 10 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 12 EE times
- ・ 2026. 3. 26 日刊工業新聞

**■半導体**

- ・ 2026. 3. 6 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 8 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 10 日刊工業新聞                      ・ 2026. 3. 12 日刊工業新聞
- ・ 2026. 3. 17 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 19 日経 Xtech
- ・ 2026. 3. 23 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 23 日刊工業新聞
- ・ 2026. 3. 27 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 28 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 31 日本経済新聞

**■新技術、材料、電池**

- ・ 2026. 3. 3 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 17 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 23 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 22 産経新聞
- ・ 2026. 3. 31 朝日新聞

**■カーエレクトロニクス**

- ・ 2026. 3. 6 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 22 日本経済新聞

**■通信 5G/6G (第5世代/第6世代通信)**

- ・ 2026. 3. 13 日刊工業新聞                      ・ 2026. 3. 19 日経 Xtech

**■環境/エネルギー/SDGs**

- ・ 2026. 3. 6 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 9 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 10 日本経済新聞

**■企業動向、製品動向**

- ・ 2026. 3. 4 日刊工業新聞                      ・ 2026. 3. 7 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 15 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 22 日本経済新聞
- ・ 2025. 3. 25 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 24 日刊工業新聞
- ・ 2026. 3. 26 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 27 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 30 日本経済新聞

**■AI、生成AI**

- ・ 2026. 3. 6 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 24 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 12 EE times

**■その他**

- ・ 2026. 3. 5 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 6 日本経済新聞
- ・ 2026. 3. 10 日本経済新聞                      ・ 2026. 3. 27 日本経済新聞